BONDING THE STARS





Dickdraht Wedge-Wedge Bonder

5350

Bond System

Drahttypen Aludrähte 100-500µm auf 4"-Spule

Kupferdrähte 100-300µm auf 4"-Spule

Bondkopf Dickdrähte-Wedge-Wedge Front-oder Backcut

Standard Tool Länge 2"

Motorisierte Drahtabspulung (optional)

Programmierbares Voice-Coil Bondkraftsystem

Von 0 bis 1.800 cN

Ultraschall System F&S Generator 58kHz (optional 40, 90, 120kHz)

Maschinen Basis

Achsen

- Programmierbare lineare Z-Achse mit 60mm Hub
- Programmierbare lineare Y-Achse mit 20mm Hub
- Standard-Arbeitshöhe: 55 mm
- Manipulator in X und Y: 18x18 mm
- entspricht Untersetzung: 1:7

Hardware

- Stepper-Motor getriebene Z-Linearachse,
- Singleboard-PC, menügeführtes Teach-In,
- interne Festplatte, Bedienung und Menü-Führung über Shuttlerad mit Quittierungstaster

Software

- programmierbare Einzelbonds
- Loopformen speicherbar

Steuerung Manuell, Teil-Automatisch

Abmessung B x T x H – 63 x 58 x 40 cm, Gewicht ca. 30kg

Anschlüsse 100-230 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 230 VA

Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

Heizung Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Die 53xx Serie:

Der Dickdraht Wedge-Wedge-Bonder 5350 verarbeitet Aluminiumdrähte von 100 bis 500 µm und Kupferdrähte von 100 bis 300µm.

Seine Besonderheit ist eine vollständig automatische Schneideinrichtung. Sie schneidet den Draht nach dem zweiten Bond perfekt reproduzierbar auf Mikrometer genau ab und schließt dadurch Schädigungen am Bauteil zuverlässig aus.

Selbst komplizierte Loopformen wie Reverse Loops oder Stitchbonds lassen sich weitgehend ohne Bedienereinfluss ausfuhren. Ungewöhn-lich für einen Handbonder ist, dass alle Parameter programmiert und auf der internen Festplatte gespeichert werden können.

Zusätzlich können sämtliche Parameter auf der internen Festplatte gespeichert werden. Das erlaubt die Bedienung auch durch wenig geschultes Personal.

Wenn auch Sie für komplexe Bondaufgaben opti-male Qualität zum günstigen Preis suchen, ist diese Maschine genau richtig für Sie.

BONDING THE STARS



Substrathalter

Standard-Substrataufnahme für Bauteile bis 2x2" mit mechanischer Klemmung



Optional:



Substrahtaufnahme für Bauteile bis 4x4" mit Vakuum und mech. Klemmung



TO Aufnahme mit mechanischer Klemmung



Ø80mm Substrataufnahme mit mechanischer Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270
Fax: +43-7722-67052-8272
Mail: info@fsbondtec.at
Web: www.fsbondtec.at

